

深圳市江波龙电子股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称及人员姓名	Polymer Capital、中信证券、长江证券自营、中安汇富、招商信诺资管、申万菱信、千禧年基金
时间	2024年6月4日（周二） 下午 15:00~16:00 2024年6月7日（周五） 上午 09:00~10:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>1、公司如何看待下半年存储市场走势？是否会有新增需求？</b></p> <p>答：目前原厂供应向企业级产品倾斜，整体存储晶圆的供应依然偏紧；其次，在价格上，原厂拉涨价格的态度目前较为坚决，今年内晶圆价格有望延续温和上涨的趋势，但各个不同应用场景下的存储器价格趋势可能出现结构化差异。各厂商之间的技术能力、市场能力及品牌能力等差异化要素的作用权重有望增大。</p> <p>随着 AI 技术广泛应用带来的海量的数据增长，对存储系统提出了更高的要求。无论是 AI 模型的训练还是推理过程，都需要大量数据的支持，需要不断推出高性能、大容量、高可靠的存储解决方案，以满足 AI 应用的需求。16GB DRAM 将成为新一代 AI 手机的基础配置，SoC 以外的硬件需要一同配套升级。随着 AI 技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI 手机渗透率大幅增长，将带动新一轮换机潮，存储市场将迎来更加广阔的发展空间。</p> <p><b>2、晶圆价格波动对公司毛利率的影响？</b></p> <p>答：因晶圆采购与产品销售之间存在周期间隔，晶圆价格上行将对公司毛利率产生一定正面影响。公司 2024 年第一季度实现了 24.39%，目前公司毛利率已处在相对健康区间。公司毛利率变动受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响，公司将不断进行产品结构的优化，加大对高毛利产品的研发和投入。</p> <p><b>3、公司 SLC NAND Flash 业务进展如何？</b></p> <p>答：公司 SLC NAND Flash 存储芯片主要应用包括汽车、安防、穿戴、IOT、家用电器、网通、工业自动化等各个应用领域，累计出货量已超过 5000 万颗。目前公司与这些主要应用领域的头部客户都已经建立了稳定的合作关</p>
---------------------------	--

系，与此同时还在国际穿戴品牌客户中取得了突破，成功导入了其旗舰产品。此外，在高可靠性的工业自动化、车载应用中公司也取得了 0 到 1 的突破。

2024 年 1 月，继自研 SLC NAND Flash 系列产品实现规模化量产后，江波龙发布首颗自研 32Gb 2D MLC NAND Flash，并于一季度完成流片验证。公司自研存储芯片业务的顺利推进，代表着公司具备了从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力，除了能够更好地开展 SLC NAND Flash 小容量存储芯片业务之外，还能更好地反哺公司大容量存储业务，从而形成从小容量存储到大容量存储的体系化竞争优势。

#### **4、公司布局主控芯片业务的原因？目前进展如何？**

答：公司布局主控芯片领域，主要是希望能够掌握主控芯片的研发技术，把客户的诉求能够及时反馈到公司的产品中，为公司向客户提供一体化存储方案提供助力，增强公司持续稳定交付产品的能力。

公司两款自研主控芯片（WM 6000、WM 5000）已经批量出货，赋能公司 eMMC 和 SD 卡两大核心产品线，并已经实现了数千万颗的规模化产品导入，助力公司中高端存储器产品固件算法自研的竞争优势，进一步增强公司整体竞争力以及产品技术护城河。

#### **5、公司业绩驱动因素有哪些？**

答：在核心技术方面，公司拓展了 SLC NAND Flash 等小容量存储芯片设计能力，并推进相较于典型存储器/模组企业，公司研发布局突破藩篱进入到集成电路设计领域，实质性构建了自研 SLC NAND Flash 存储芯片设计业务，产品获得客户认可实现量产销售，代表着公司具备了从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力。另一方面，公司已经推出了 eMMC 和 SD 卡主控芯片（已批量

应用), 并匹配自研固件算法的既有竞争力后, 能够高效率满足客户, 特别是大客户的产品性能要求, 并且在售后服务故障解决等领域以自有能力帮助客户快速解决问题, 从而最终建立起主营业务的进入壁垒, 增加大客户黏性。

封测制造方面, 公司已在封装设计、测试算法及测试软件方面等储备了多年的实力, 并于 2023 年完成了元成苏州和 Zilia 的并购, 这是加强全球供应链布局, 进一步开拓海外市场的重要举措, 有助于公司形成全球化产能与国内产能兼顾、自主产能与委外产能并行的制造格局。

品牌优势方面, 公司拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar (雷克沙)。公司经过十多年的技术积累, 打造了 FORESEE 品牌并在存储行业拥有良好的口碑; Lexar (雷克沙) 是大陆地区为数不多的拥有高端消费类存储品牌的企业, 在全球市场具有较高影响力。

供应链方面, 公司凭借应用技术、产品设计和市场销售优势, 帮助晶圆原厂快速实现晶圆的产品化; 其次, 公司与国内外主要存储晶圆原厂签署了长期合约, 确保存储晶圆供应的稳定性, 巩固公司在下游市场的供应优势。

总体来说, 公司未来将通过不断投入研发, 改善及提升产品结构, 在企业级存储、车规工规级存储以及 Lexar (雷克沙) 品牌业务等主要领域取得进一步的突破。

## **6、公司目前备货策略?**

答: 公司采用以需求为基本牵引, 结合市场综合因素判断的采购策略。公司 2024 年一季度营业收入 44.53 亿元, 同比增长 200.52%, 随着公司整体销售规模的不断增长, 公司存货金额也会相应增加; 与此同时, 公司大客户有所新增 (如 OPPO 等), 大客户非常关注公司持续供应能力, 公司相应增加备货; 此外, 从目前行业来看, 参与各方 (包括公司在内) 均认为存储晶圆的价格在未来一段时

间内将保持上涨的态势，公司存货的备货策略也会与下行周期有所差异。

#### **7、公司与金士顿的合作进展及规划？**

答：2023年，公司与金士顿科技共同签署了意向性备忘录，宣布发挥各自优势，将共同出资设立合资公司。目前双方正在就合作的细化安排做进一步协商，以稳妥地推进合资公司的设立等各项事宜。

#### **8、来自信创行业的收入在公司总体营收中占比有多大？未来展望如何？**

答：公司暂时未单独统计在信创行业的收入。公司对党政信创、行业信创并重。在党政信创领域，公司主要与下游大型OEM整机厂积极配合。在行业信创领域，目前看到以电信运营商为代表的部分行业信创市场有所起色，预计今年会有更多新增需求。信创市场对应公司的主力产品线集中在企业级存储业务，由于行业信创涉及到每一个采购主体各自的采购程序，包括采购程序之前的产品验证导入的过程，因此在前两年企业级产品完成验证程序的基础之上，公司未来在信创行业将迎来更多的参与机会。公司企业级存储业务在今年预计会有一定受益。

#### **9、如何看待 eMMC 向 UFS 的迭代？公司 UFS 相关产品的进展如何？**

答：随着 eMMC 向 UFS 的迭代，公司在市场上已具备一定的先发优势，持续多年投入对 UFS 新一代嵌入式存储、集成式嵌入式存储（即 ePOP、eMCP 等）的研发。目前，公司的 UFS 2.2 和 UFS 3.1 产品已经量产，公司 UFS 新一代存储器产品均采用公司自主研发固件，能够快速响应及解决来自不同细分市场的需求，为客户提供传输速率更高、容量更大的存储方案，保证公司在 eMMC 向 UFS 过渡关键时点仍然拥有领先的市场地位及技术优势。

	<p><b>10、目前下游需求如何？哪些领域需求会更好一些？</b></p> <p>答：目前中高端产品需求稳定性高于低端产品，公司将进一步发挥在企业级服务器存储、车规工规级存储，以及嵌入式存储大客户拓展的先发优势，把握市场节奏，持续提升经营效益。</p> <p><b>11、公司企业级存储业务进展情况？</b></p> <p>答：公司是国内少有的 eSSD 和 RDIMM 两类产品协同发展的企业，其中公司 eSSD 已经在多个核心客户处完成了认证和量产，广泛应用于通信、金融、互联网等行业，并在多个客户处取得了极高的性能和质量评价；RIDMM 方面，公司已经完成了从 16G 到 96G 所有主流容量产品的布局。</p> <p>未来国内企业级存储市场有望保持增长态势，公司将有效地捕捉并利用这一市场机遇。目前公司企业级存储业务发展势头良好，亦是公司业绩增长新动能之一。</p>
附件清单（如有）	无